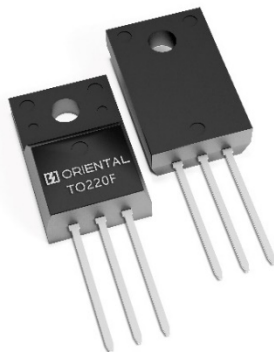


TO220F 封装型式

1、目前常规封装为 TO247,封装体积大, 散热面积大, 一般需要配合散热器紧密贴合。主要应用大功率新能源领域。



2、TO220F 封装是电子元器件常采用的一种直插式的小型封装形式。产品全塑封, 可以实现散热片和外部的电器绝缘。封装体积较小, 无需散热器。



3、东微半导体推出 TO220F 封装, 具有极大降低开关损耗和杜绝散漏电可能性等优点, 可用于高频电源、风力发动机、列车牵引系统等领域。



4、该产品采用全塑封装，在通风条件良好、对绝缘要求较高的应用时，能够杜绝散热片处的电气连接造成漏电的可能性，让电路整体保持良好的绝缘性。产品是具有耐高温特点的单极型器件，可以极大降低开关的损耗，很好的提高整体的效率并减少能量的浪费，同时大大减少产品的体积，这让其一些高功率密度和空间受限的条件下具有很大的优势。